

证券代码：300219

证券简称：鸿利智汇

公告编号：2023-054

## 鸿利智汇集团股份有限公司

### 关于关联方还款暨借款逾期的进展公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、关联借款情况概述

鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月13日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于与关联方签署产权交易合同暨关联交易的议案》。同意公司转让全资子公司广东省金材科技有限公司（以下简称“金材科技”）80%股权。金材科技作为公司全资子公司期间，公司陆续向其提供资金作为日常生产经营使用，截至上述股权转让，金材科技向公司借款余额为19,691.39万元。2021年9月，公司与金材科技签署了《还款协议》，约定上述欠款由金材科技在2027年9月30日还清。

因金材科技正处于转型阶段，资金情况较为紧张，导致其未能按《还款协议》约定归还到期本金12,325,775.56元。公司于2023年10月18日在巨潮资讯网发布《关于向关联方提供借款逾期的公告》（公告编号：2023-052）。

#### 二、还款进展情况

截止本公告披露日，公司已收到金材科技归还的上述逾期欠款12,325,775.56元，其中现金方式支付9,989,661.59元，银行承兑汇票支付2,336,113.97元。金材科技剩余未还欠款仍需按《还款协议》约定分期偿还，公司将持续关注金材科技的生产经营情况，推进金材科技履行还款计划事项，维护公司及股东的合法权益。

公司将根据后续进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

鸿利智汇集团股份有限公司董事会

2023年10月25日